

TEST ENGINEER

근무 부서: Test Team

근무지: 대전(신입,경력)/서울(경력) - 근무지 면접 후 결정

자격요건

• 공통

- (1) 전자/전기 계열 학사 이상 졸업 또는 졸업 예정
- (2) 나이/성별 무관

• 경력

- (1) 반도체 ATE test 분야 만 3년 이상의 경력

• 신입

- (1) 2022년 2월 졸업 이후 또는 2023년 졸업 예정
- (2) 학사 졸업 학점 3.3 이상 (4.5 기준)
- (3) TOEIC 700, TOEIC-S 130, OPIC IM2 이상 또는 동 수준의 어학 점수

수행업무

• 경력

- (1) 제품 특성 및 양산용 자동화 test 프로그램 개발을 위한 plan 작성
- (2) Probe cards 및 load boards 설계 및 제작
- (3) Wafer 및 PKG 테스트를 위한 자동화 프로그램 개발 (ex. Teradyne, Verigy)
- (4) 데이터 및 통계 분석 tool을 활용하여 제품특성 및 테스트 데이터 분석

• 신입

- (1) 테스트 업무에 요구되는 기초 학습 및 세미나
- (2) 완성된 테스트 프로그램 학습 및 검증
- (3) 테스트 결과에 대한 결과 정리 및 데이터 분석

우대사항

- 반도체 회로와 PCB 설계에 대한 실무 지식 보유자 우대
- Wafer 및 final test program 개발 경험자
- MATLAB, C++, Python 등 program 능통자
- 통계 데이터 분석을 통해 수율 및 불량 분석 경험자 우대

H/W - APPLICATION ENGINEER

근무 부서: Application Engineering Team

근무지: 대전(신입,경력)

자격요건

• 공통

- (1) 전자/전기/통신 계열 학사 이상 졸업 또는 졸업 예정
- (2) 나이/성별 무관

• 경력

- (1) H/W application 분야 만 2년 이상의 경력

• 신입

- (1) 2022년 2월 졸업 이후 또는 2023년 졸업 예정
- (2) 학사 졸업 학점 3.3 이상 (4.5 기준)
- (3) TOEIC 700, TOEIC-S 130, OPIC IM2 이상 또는 동 수준의 어학 점수

수행업무

• 경력

- (1) 벤치마킹 및 반도체 기능/성능 테스트 수행
- (2) PCB 설계 및 제작, 디버깅 및 설계 가이드 제공
- (3) 시스템 레벨의 chip 검증 테스트, H/W 특성 최적화
- (4) 기술 지원
 - 제품 시연 및 시스템 협업 개발, 검증 업무 지원
 - 기술 문서 작성

• 신입

- (1) PCB 회로 설계에 요구되는 기초 학습
- (2) PCB artwork 및 BOM 관리
- (3) Chip 기능/성능 평가 수행 및 문서 작성

우대사항

- PCB 설계 (Altium, PADs) 및 Auto CAD 설계 전문성
- MCU 운용 및 DSP 업무 활용 전문성
- 반도체 분야 H/W 개발 전문성
- 전장 부품 및 BMS 등 배터리 관련 분야 전문성